

M8 PASTA NO CLEAN

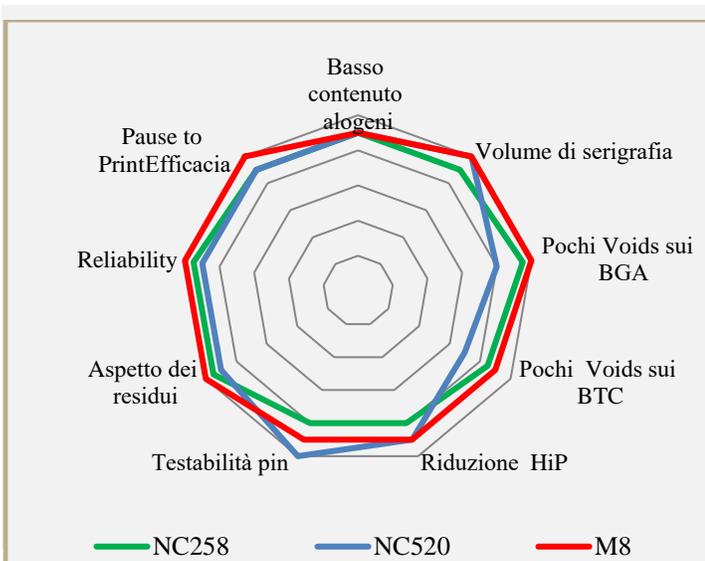
FEATURES

- Pochi voids <5% su BGA and <10% on BTC
- Eccellente efficienza in serigrafia <0,50 AR
- Elimina i difetti HiP
- Conforme a REACH e RoHS * – Esente da alogeni
- Formulata per uso con polveri T4 ed inferiori
- Ottima bagnabilità su finiture lead-free
- Minimi residui trasparenti -idonea per LED
- Passa Bono Automotive SIR Test

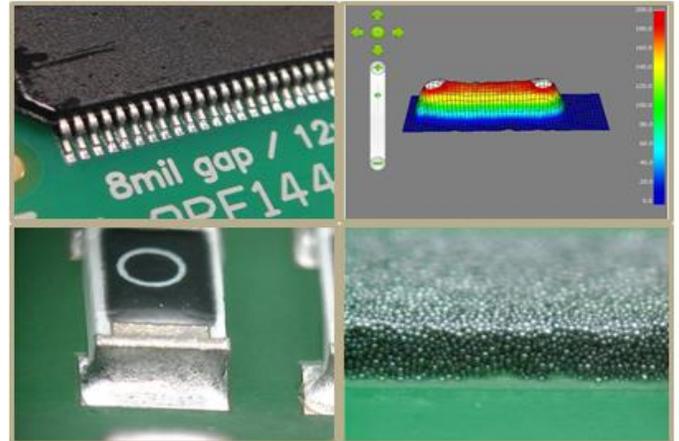
DESCRIZIONE

Sviluppata per lavorare con polveri T4 ed inferiori, sia leadfree che con piombo, M8 garantisce elevata stabilità di serigrafia anche nei componenti UFP e microBGA, riducendo la difettosità anche nelle applicazioni più complicate. Gli attivatori della M8 riducono i difetti di bagnabilità, come HiP e garantiscono saldature brillanti. M8 riduce i voids su BGA e BTC and un livello inferiore al 5% (BGA) e al 10% (BTC). M8 supera i SIR test più restrittivi del settore automotive e soddisfa i parametri dei test elettrochimici.

CARATTERISTICHE



*Leghe lead free.



MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Parametro	Tempo	Temperatura
Scadenza refrigerata e sigillata	1 anno	0°C-12°C (32°F-55°F)
Scadenza non refrigerata	3 mesi	< 25°C (< 77°F)

Non mischiare pasta usata con pasta fresca. Stoccare la pasta usata separatamente. Mantenere la pasta non usata rigorosamente sigillata con le chiusure originali. Dopo l'apertura, la deperibilità dipende dalle condizioni ambientali e dall'applicazione. Riferirsi alle linee guida AIM per ulteriori informazioni. Lega e condizioni di stoccaggio possono influire sulla scadenza. Riferirsi al Certificato di analisi per informazioni specifiche sul prodotto.

PULIZIA

Prima del reflow: AIM DJAW-10 rimuove efficacemente la pasta M8 dalle lamine durante il processo. DJAW-10 può essere applicato a mano o usato con i sistemi di pulizia sotto alla lamina. DJAW-10 non secca la M8 e migliora la trasferibilità. Non applicare DJAW-10 sulla parte superiore della lamina, L'alcol isopropilico non è raccomandato durante il processo, ma può essere utilizzato come risciacquo finale. rin

Residui Post-Reflow: Non è necessario rimuovere i residui di M8. Nel caso fosse obbligatorio il lavaggio contattare AIM, che fornirà una tabella di compatibilità con i maggiori solventi in commercio.

PROFILO DI RIFUSIONE

Detailed profile information may be found at <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Contact AIM for additional information.

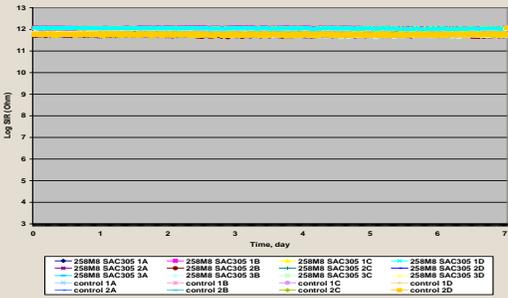
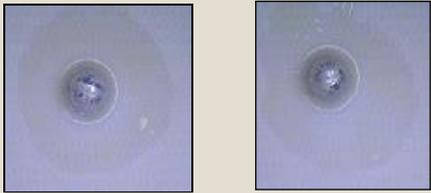
PRINTING

Recommended Initial Printer Settings - Dependent on PCB and Pad Design	
Parameter	Recommended Initial Settings
Squeegee Pressure	0.4 - 0.7kg/25mm
Squeegee Speed	13 – 152 mm/second
Snap-off Distance	On Contact 0.00 mm
PCB Separation Distance	0.75 - 2.0 mm
PCB Separation Speed	3 - 20 mm/second

TEST DATA SUMMARY

Name	Test Method	Results	
IPC Flux Classification	J-STD-004	ROL0	
IPC Flux Classification	J-STD-004B 3.3.1	ROL1	
Name	Test Method	Typical Results	Image
Mass Density*		4.2 gr/cm ³ (SAC305)	
Copper Mirror	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	LOW	
Corrosion	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASS	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Before</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>After</p>  </div> </div>
Quantitative Halides	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	Br: 0.24% Cl: 0.0% Typical	
Qualitative Halides, Silver Chromate	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASS	
Qualitative Halides, Fluoride Spot	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	No fluoride	

*Mass density applies to SAC305 only. For all other alloys please contact AIM.

Name	Test Method	Typical Results	Image
Surface Insulation Resistance	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	All measurements on test patterns exceed 100 MΩ	
Bono Testing		PASS Fc < 8.0 Typical	
Oxygen Bomb Halogen Testing	EN14582:2007 SW 9056 SW 5050	Br 265 mg/Kg Cl < 122 mg/Kg	
Electrochemical Migration	J-STD-004B 3.4.1.5 IPC-TM-650 2.6.14.1	PASS	
Flux Solids, Nonvolatile Determination	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	94.8% Typical	
Acid Value Determination	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	136 mgKOH/g flux Typical	
Viscosity (Brookfield)	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	400-1000 Kcps	
Viscosity (Malcolm)	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	120 Pa.S Typical	
Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	PASS	
Slump	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASS	
Solder Ball	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASS	 <p style="text-align: center;">15 min 4 hrs</p>
Tack	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	36.1 gf Time 0 Typical	